

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Практические аспекты создания перспективных МДП структур
с применением технологии атомно-слоевого осаждения

А. Ю. Алябьев, А. С. Коротков

243

Оптимизация режимов ретроградного легирования кармана КНИ
МОП-транзисторов СБИС

*А. В. Амирханов, С. И. Волков, А. А. Глушко,
Л. А. Зинченко, В. В. Макарчук, В. А. Шахнов*

252

Исследование процесса образования окисной пленки нанометровой толщины
на поверхности нитрида титана методом вторично-ионной масс-спектрометрии

В. М. Мордвинцев, В. В. Наумов, С. Г. Симакин

258

Релаксационная модификация морфологии атомно-чистой поверхности
кристаллов кремния (100) после СВЧ плазменной обработки

Р. К. Яфаров

273

Исследование характеристик и особенностей изготовления элементов
энергонезависимой памяти FRAM, полученных с использованием
процессов атомно-слоевого осаждения

*О. М. Орлов, А. М. Маркеев, А. В. Зенкевич, А. Г. Черникова,
М. В. Спиридонов, Р. А. Измайлова, Е. С. Горнёв*

280

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Особенности кинетики процесса СМР периодических структур
при нелинейной зависимости скорости полирования от давления

Р. В. Гольдштейн, Т. М. Махвиладзе, М. Е. Сарычев

289

КИНЕТИКА ПЛАЗМЫ

Кинетика нейтральных частиц в плазме HCl и HVg в условиях низких давлений
и высоких концентраций электронов

А. М. Ефремов

298

МАТЕРИАЛЫ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

Тонкопленочный отрицательный электрод на основе композита кремния
для литий-ионных аккумуляторов

*А. А. Айрапетов, С. В. Васильев, Т. Л. Кулова, М. Е. Лебедев, А. В. Метлицкая,
А. А. Мироненко, Н. Ф. Никольская, В. В. Одипоков, Г. Я. Павлов, Д. Э. Пухов,
А. С. Рудый, А. М. Скундин, В. А. Сологуб, И. С. Федоров, А. Б. Чурилов*

305

РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ

Методика регистрации многократных сбоев в микросхемах памяти большой
емкости при воздействии отдельных ядерных частиц

А. Б. Боруздина, А. В. Уланова, А. И. Чумаков, А. В. Яценко

313

Вниманию авторов

319